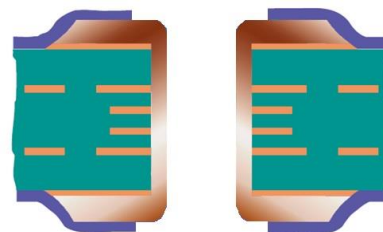


Viahål – våra alternativ

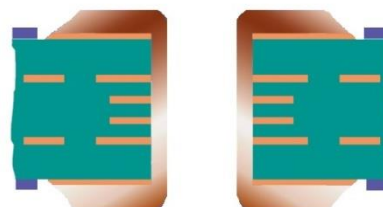
Vented via – Cogra standard

När viahålen är täckta i underlaget och inget annat anges öppnar vi upp lödmasken 0,2 mm större än angiven håldiameter.



Normal via

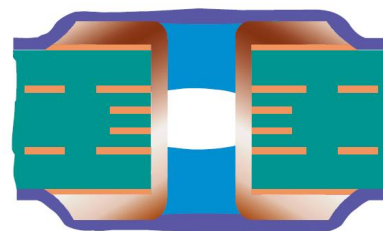
När det finns öppningar för viahålen i lödmasken optimeras dessa.



Cogra viafyllning

Liknande IPC 4761 typ IV-b men med lödmask. Efter etsning trycks lödmask in i viahålen. Därefter beläggs kortet med lödmask i den normala processen. Viahålen är inte öppnade i lödmasken. Inget övrigt oxidskydd på hålväggarna.

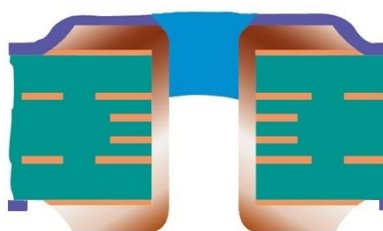
Samma utförande oavsett HASL eller ENIG som oxidskydd.



Cogra viapluggning

Liknande IPC 4761 typ III-a men efter varmförtening. Viahålen är öppnade i lödmasken. Öppningen pluggas med lödmask från ena sidan. Tenn under pluggen och på hålväggarna.

Ej tillämpligt med ENIG som oxidskydd.



När underlaget innehåller viahål i eller alldeles i närheten av en smd-pad kontaktas kunden för diskussion hur det skall utföras. Vi fyller inga viahål med epoxi eller koppar, varför utförandet av dessa viahål måste klaras ut innan produktionsstart.